

## Patentansprüche

1. Verfahren zum Strukturieren,

bei dem die folgenden Verfahrensschritte ausgeführt werden:

5 Aufbringen einer Hilfsschicht (14, 14c) auf ein Trägermateri-  
al (12, 10c),

Aufbringen einer Maskenschicht (16, 16c) auf die Hilfsschicht  
(14, 14c) vor dem Erzeugen einer Aussparung (18, 18c),

10 Strukturieren der Maskenschicht (16, 16c) mit einem lithogra-  
fischen Verfahren,

Strukturieren der Hilfsschicht (14, 14c) und des Trägermate-  
rials (12, 10c) unter Erzeugen der Aussparung (18, 18c) gemäß  
der strukturierten Maskenschicht (16, 16c),

15 danach Aufweiten der Aussparung (18, 18c) im Bereich der  
Hilfsschicht (14, 14c) durch isotropes Rückätzen, wobei die  
Aussparung (18, 18c) im Bereich des Trägermaterials (12, 10c)  
nicht oder nicht so stark wie im Bereich der Hilfsschicht  
(14, 14c) aufgeweitet wird,

20 Auffüllen der aufgeweiteten Aussparung (18b, 18d) mit einem  
Füllmaterial (22, 22c),

Entfernen der Hilfsschicht (14, 14c) nach dem Auffüllen,

25 Strukturieren des Trägermaterials (12, 10c) unter Verwendung  
des Füllmaterials (22, 22c) als Maske und unter Erzeugen min-  
destens einer weiteren Aussparung.

2. Verfahren nach Anspruch 1, g e k e n n z e i c h n e t  
d u r c h den Schritt:

Planarisieren des Füllmaterials (22, 22c) vor dem nochmaligen  
Strukturieren.

30 3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a -  
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass es zum Erzeugen

einer minimalen Strukturbreite kleiner als einhundert Nanometer verwendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,  
5 zeichnet, dass es zum Erzeugen einer minimalen Strukturbreite kleiner als fünfzig Nanometer verwendet wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Schritte:

10 Ausbilden einer Maskenschicht (12) als Trägermaterial vor dem Aufbringen der Hilfsschicht (14),  
Strukturieren eines Grundmaterials (10) unter Verwendung der Maskenschicht (12) nach dem Strukturieren des Trägermaterials (12) unter Verwendung des Füllmaterials (22).

15

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch den Schritt:

Verwenden eines Halbleitermaterials (10c) als Trägermaterial (10c), insbesondere eines einkristallinen Halbleitermaterials  
20 (10c).

7. Verfahren nach Anspruch 6, gekennzeichnet durch den Schritt:

Ausbilden mindestens einer Schicht (50, 52) in der aufgeweiteten Aussparung (18d) vor dem Auffüllen, insbesondere einer  
25 elektrisch isolierenden Schicht (50) und einer elektrisch leitfähigen Schicht (52).

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,  
30 zeichnet, dass die Schicht (50, 52) mit einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 strukturiert wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, g e k e n n -  
z e i c h n e t durch die Schritte:

Füllen der weiteren Aussparung mit einem weiteren Füllmateri-  
al (70),

- 5 Entfernen des zur Strukturierung dienenden Füllmaterials (22,  
22c) nach dem Füllen der weiteren Aussparung.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, g e k e n n -  
z e i c h n e t durch die Schritte:

- 10 teilweises Entfernen des Füllmaterials (22, 22c) aus der Aus-  
sparung (18, 18c), wobei ein Teil des Bodens der Aussparung  
(18, 18c) freigelegt wird und ein anderer Teil des Bodens der  
Aussparung (18, 18c) mit Füllmaterial (22, 22c) bedeckt  
bleibt.

15

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10, g e k e n n -  
z e i c h n e t durch den Schritt:

- Oxidation des Halbleitermaterials (10c) im Bereich zwischen  
der Aussparung (18c) und der weiteren Aussparung, insbesonde-  
20 re in einem sich von der Aussparung (18c) zu der weiteren  
Aussparung erstreckenden Zwischenbereich,  
vorzugsweise vor dem Entfernen des Füllmaterials (22c) und  
vorzugsweise nach dem Erzeugen einer Oxidationsschutzschicht  
(80) an mindestens einer Seitenwand der weiteren Aussparung.

25

12. Feldeffekttransistor (100),  
mit zwei Kanalanschlussbereichen (104, 106),  
mit einem Steuerbereich (52, 62), der mindestens zwei Steuer-  
bereichsabschnitte enthält,

- 30 mit einem als Vorsprung (56) eines einkristallinen Substrates  
(10c) ausgebildeten aktiven Bereich, der einerseits zwischen  
den Kanalanschlussgebieten (104, 106) und andererseits zwi-  
schen zwei Steuerbereichsabschnitten angeordnet ist,

und mit elektrisch isolierenden Isolierbereichen (50, 60),  
die zwischen den Steuerbereichsabschnitten und dem aktiven  
Bereich (56) angeordnet sind,  
wobei der Vorsprung (56) durch ein elektrisch isolierendes  
5 Isoliermaterial (82) an seiner Basis vom Substrat (10c) ge-  
trennt ist,  
und wobei das Isoliermaterial (82) am Vorsprung (56) in dem  
einkristallinen Substrat (10c) lateral endet.

10 13. Feldeffekttransistor (100) nach Anspruch 12, d a d u r c h  
g e k e n n z e i c h n e t , dass zwei an der Basis des Vor-  
sprungs liegende Seitenflächen des Vorsprungs (56) quer an  
zwei Substratflächen des Substrats (10c) grenzen, die in zwei  
zueinander beabstandeten Ebenen angeordnet sind, wobei der  
15 Abstand (D) größer als ein Nanometer, größer als drei Nanome-  
ter oder größer als fünf Nanometer ist.

14. Feldeffekttransistor (100) nach Anspruch 12 oder 13,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Steuerbe-  
20 reichsabschnitte an den beiden Seitenflächen des Vorsprungs  
(56) ausgebildet sind.

15. Feldeffekttransistor (100) nach einem der Ansprüche 12  
bis 14, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das I-  
25 soliermaterial (82) nicht über mindestens eine Seitenfläche  
des Vorsprungs (56) hinausragt.